

NC273LT NO CLEAN LÖTPASTE

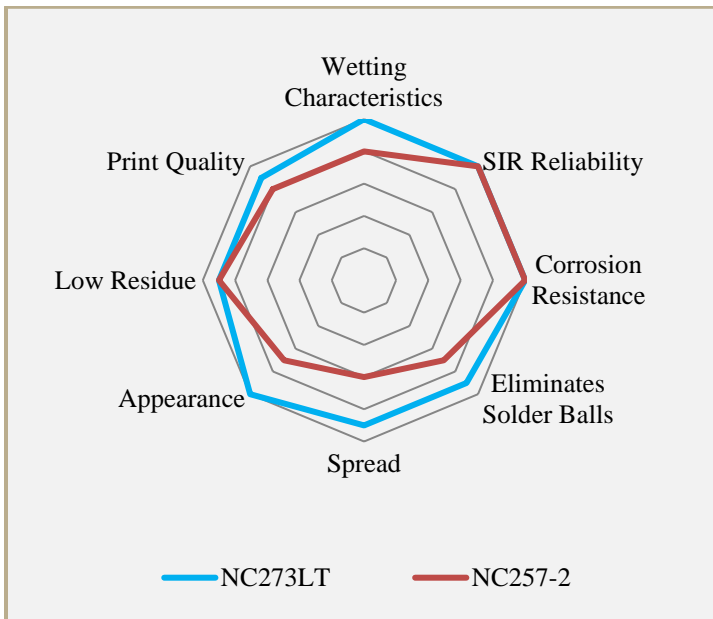
MERKMALE

- Entwickelt für Niedrigtemperaturanwendungen
- RoHS-konform
- Verbesserte Benetzung für Bismut-Legierungen
- Reduziert Lötkegelbildung
- >8 tunden Standzeit auf der Schablone
- Halogenfrei

BESCHREIBUNG

Das revolutionäre Aktivatorsystem in der Niedrigtemperatur-Lotpaste NC273LT von AIM verbessert die Benetzungsleistung von Wismut-Legierungen bis hin zu RoHS-konformen Beschichtungen und Oberflächenfinishes. NC273LT bietet eine lange Standzeit auf der Schablone, eine hervorragende Übertragungseffizienz und minimiert die für Wismut-Legierungen übliche Lotkugelbildung. Wenn die thermische Belastung während des Montageprozesses eine Einschränkung darstellt, ist NC273LT ein ausgezeichneter RoHS-konformer Ersatz. Wismuthaltige Lötpasten reduzieren die Anforderungen an die Reflow-Spitztemperatur auf bis zu 170°C-185°C (338°F-365°F). Wie bei jeder wismuthaltigen Legierung muss die Baugruppe vollständig bleifrei sein.

EIGENSCHAFTEN



HANDHABUNG UND LAGERUNG

Parameter	Zeit	Temperatur
Versiegelt, gekühlt, Haltbarkeit	3 Monate	0°C-12°C (32°F-55°F)
Versiegelt ungekühlt haltbar	1 Woche	< 25°C (< 77°F)

Gebrauchte Paste nicht mit frischer Paste vermischen. Lagern Sie die gebrauchte Paste separat; halten Sie die frische Paste fest verschlossen mit dem inneren Stopfen oder der Endkappe in Position. Nach dem Öffnen ist die Haltbarkeit der Lötpaste von der Umgebung und der Anwendung abhängig. Weitere Informationen finden Sie in den AIM-Richtlinien zur Handhabung von Lotpasten. Legierung und Lagerbedingungen können die Haltbarkeit beeinflussen. Produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem NC273LT-Analysezertifikat.

REINIGUNG

Vor dem Reflow: AIM DJAW-10 entfernt effektiv die NC273LT-Lotpaste von den Schablonen während des Prozesses. DJAW-10 kann von Hand aufgetragen oder in einem Schablonenreinigungsgerät verwendet werden. DJAW-10 trocknet NC273LT nicht und verbessert die Übertragungseigenschaften. Nicht zu viel DJAW-10 auftragen. DJAW-10 nicht auf die Schablonenoberseite auftragen. Isopropanol (IPA) wird für den Prozess nicht empfohlen, kann aber als abschließende Schablonenspülung verwendet werden.

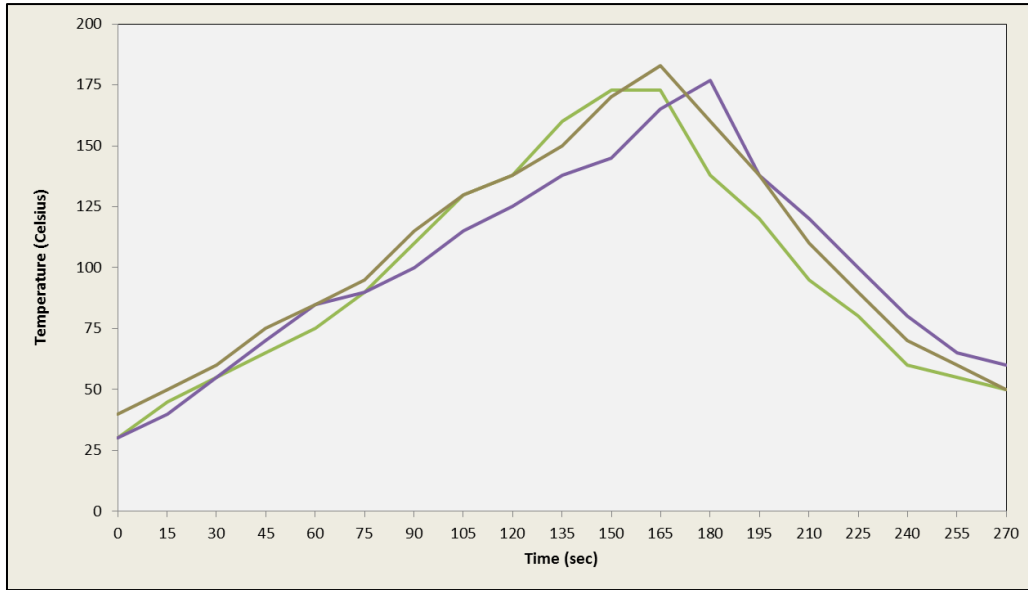
Post-Reflow-Flussmittelrückstände: NC273LT-Rückstände können nach dem Reflow-Prozess auf der Baugruppe verbleiben und müssen nicht gereinigt werden. In Fällen, in denen eine Reinigung vorgeschrieben ist, hat AIM eng mit Industriepartnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass NC273LT-Rückstände mit den üblichen Reinigungsmitteln effektiv entfernt werden können. Wenden Sie sich an AIM für Informationen zur Reinigungskompatibilität.

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie dürfen nicht als Spezifikationen für eingehende Produkte oder für die Prozessgestaltung verwendet werden. Für produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat. Document Rev # NF9

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Daten, die für korrekt gehalten werden, und werden kostenlos angeboten. Die Produktinformationen beruhen auf der Annahme einer ordnungsgemäßen Handhabung und Betriebsbedingungen. Eine Haftung für Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen oder der Verwendung der angegebenen Materialien ergeben, wird ausdrücklich abgelehnt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AIM finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

REFLOW PROFIL

Der schraffierte Bereich unten zeigt das Prozessfenster des Profils, Ihr Profil kann davon abweichen. Bauteilbeschränkungen, Ofeneffizienz, Größe/Masse der Leiterplatte, Bauteiltyp und -dichte beeinflussen das optimierte Reflow-Profil. Diese Empfehlungen sind Richtlinien. Wenden Sie sich an AIM für Unterstützung bei der Profilerstellung.



Anstiegsgeschwindigkeit 1-3° C / Sek Max	Rampe bis 100° C (212° F)	Anstieg über100° C- 140° C (212° F-284° F)	bis Spitzentemperatur 170° C-185° C (338° F-365° F)	Zeit über138° C (280° F)	Abkühlung ≤ 4° C / SEK	Zeit bis zum Anstieg
	≤ 75 Sek	30-60 Sek	45-75 Sek	50-80 Sec	45± 15 Sek	2,75-3,5 Min


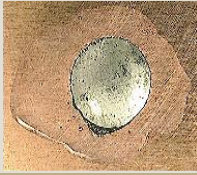


DRUCKEN

Empfohlene Anfangseinstellungen des Druckers - abhängig von PCB und Pad Design	
Parameter	Empfohlene Anfangseinstellungen
Rakeldruck	0,9 -1,5 lbs/inch der Klinge
Rakelgeschwindigkeit	0,5 - 6 Zoll/Sekunde
Absprungabstand	bei Kontakt 0,00 mm
PCB Trennungsabstand	0,75 – 2,0 mm
PCB-Trennungsgeschwindigkeit	3 - 20 mm/Sekunde

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie dürfen nicht als Spezifikationen für eingehende Produkte oder für die Prozessgestaltung verwendet werden. Für produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat. Document Rev # NF9

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Daten, die für korrekt gehalten werden, und werden kostenlos angeboten. Die Produktinformationen beruhen auf der Annahme einer ordnungsgemäßen Handhabung und Betriebsbedingungen. Eine Haftung für Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen oder der Verwendung der angegebenen Materialien ergeben, wird ausdrücklich abgelehnt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AIM finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

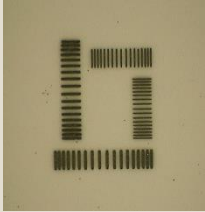

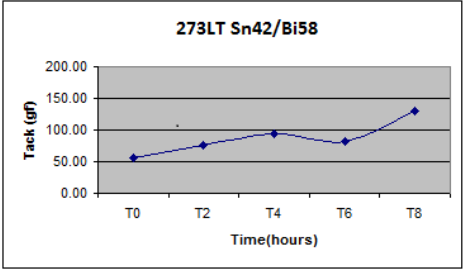

ZUSAMMENFASSUNG DER TESTDATEN

Name	TESTMETHODE	ERGEBNISSE	
IPC-Flussklassifizierung	J-STD-004 3.2.3.1	ROLO	
IPC-Flussklassifizierung	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
NAME	TESTMETHODE	TYPISCHE ERGEBNISSE	BILD
Kupferspiegel	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	Niedrig	
Korrosion	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASS	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Vor</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Nach</p>  </div> </div>
Quantitative Halogenide	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0,23% Cl: 0,0% Typisch	
Halogengehalt	EN14582	<900ppm Br/Cl <1500ppm Kombiniert	Halogenfrei
Qualitative Halogenide, Silberchromat	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASS	
Qualitative Halogenide, Fluoridfleck	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Kein Fluorid	
Oberflächen-Isolationswiderstand	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASS	
Flussmittel Feststoffe, nicht flüchtige Bestimmung	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3,17 Typisch	
Bestimmung der Säurezahl	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	159,4 mg KOH/ g Flussmittel	
Bestimmung des spezifischen Gewichtes des Flussmittels	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0,98 Typisch	
Viskosität	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	Druckformel: 750kcps Typisch Dosierformel: 400kcps Typisch	

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie dürfen nicht als Spezifikationen für eingehende Produkte oder für die Prozessgestaltung verwendet werden. Für produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat. Document Rev # NF9

Page 3 of 4

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Daten, die für korrekt gehalten werden, und werden kostenlos angeboten. Die Produktinformationen beruhen auf der Annahme einer ordnungsgemäßen Handhabung und Betriebsbedingungen. Eine Haftung für Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen oder der Verwendung der angegebenen Materialien ergeben, wird ausdrücklich abgelehnt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AIM finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.

NAME	TESTMETHODE	TYPISCHE ERGEBNISSE	BILD												
Visuell	J-STD-004B 3.4.2.5	Grau, glatt, cremig													
Fließen	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	BESTANDEN													
Lötugel	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	BESTANDEN													
Heftzwecke	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	55.3gf Typisch	 <table border="1"> <caption>273LT Sn42/Bi58 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time (hours)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T0</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>T2</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>T4</td> <td>95.00</td> </tr> <tr> <td>T6</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td>T8</td> <td>130.00</td> </tr> </tbody> </table>	Time (hours)	Tack (gf)	T0	50.00	T2	75.00	T4	95.00	T6	80.00	T8	130.00
Time (hours)	Tack (gf)														
T0	50.00														
T2	75.00														
T4	95.00														
T6	80.00														
T8	130.00														
Benetzung	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	BESTANDEN													

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie dürfen nicht als Spezifikationen für eingehende Produkte oder für die Prozessgestaltung verwendet werden. Für produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat. Document Rev # NF9

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf Daten, die für korrekt gehalten werden, und werden kostenlos angeboten. Die Produktinformationen beruhen auf der Annahme einer ordnungsgemäßen Handhabung und Betriebsbedingungen. Eine Haftung für Verluste oder Verletzungen, die sich aus der Verwendung dieser Informationen oder der Verwendung der angegebenen Materialien ergeben, wird ausdrücklich abgelehnt. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von AIM finden Sie unter <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> to review AIM's terms and conditions.